

# W-GM-5200

## Wafer Edge Grinding Machine

- ベストセラー機 W-GM シリーズ
- コンパクトな設計でスペース効率アップ
- X軸・Y軸・ $\theta$ 軸の同期補完制御による高精度な研削
- タッチパネルによる簡単操作
- 研削結果の測定と自動補正が可能



## W-GM-5200 仕様

### 基本仕様

ウェーハサイズ	φ 300 mm
ウェーハの厚さ	0.6 ~ 1.0 mm
ウェーハ形状	φ 300 mm (ノッチ付き)
<b>外周研削</b>	
砥石外径 溝部	φ 200 mm
砥石外径 外周	φ 202 mm
砥石内径	φ 30 mm
砥石フランジ厚	20 mm
スピンドル回転数	5000 rpm
スピンドル軸受け方式	グリース潤滑・メカニカル軸受け方式
スピンドル駆動方式	ビルトインモータ方式
研削スピード	任意設定可能
<b>ノッチ研削</b>	
砥石外径 溝部	φ 1.8 ~ 2.4 mm
砥石外径 外周	φ 3.8 mm
砥石シャンク径	φ 3 mm
スピンドル回転数	80000 rpm
スピンドル軸受け方式	エア軸受け方式
スピンドル駆動方式	エアタービン方式
シグナルタワー	3色表示灯 (色・点滅・点灯はキー入力で変更可)
<b>オプション</b>	
<b>低歪研削</b>	
スピンドル回転数	36000 rpm
スピンドル軸受け方式	エア軸受け方式
スピンドル駆動方式	高周波ビルトイン方式
ノッチ精研スピンドル回転数	150000 rpm
スピンドル軸受け方式	エア軸受け方式
スピンドル駆動方式	高周波ビルトイン方式
<b>砥石形状 (外周精研)</b>	
砥石外径 溝部	φ 46.6 ~ 42 mm
砥石外径 外周	φ 50 mm
砥石フランジ厚さ	15 mm
<b>砥石形状 (ノッチ研削)</b>	
砥石外径 溝部	φ 1.8 ~ 2.2 mm
砥石外径 外周	φ 3.8
砥石シャンク径	φ 3 mm

### 機構部仕様

<b>ウェーハ厚さ測定</b>	
分解能	1 μm
繰り返し測定精度	± 2 μm 以内
測定方法	非接触方式
<b>アライメント機構</b>	
方式	レーザー方式
分解能	1 μm
センタリング精度	± 50 μm 以内
<b>研削テーブル直線軸 (X/Y/Z)</b>	
分解能	1 μm
駆動方式	AC サーボモータとボールネジ
<b>研削テーブル回転軸 (θ)</b>	
分解能	0.001°
駆動方式	DD モータと高分解機構
<b>研削テーブル平面度</b>	
面振れ	10 μm 以下 / 360°
<b>トランスファー部</b>	
搬送方式	吸着搬送
真空発生源	真空エジェクタ
ウェーハ確認センサ	真空センサ
<b>洗浄部</b>	
洗浄方式	スピナ洗浄
乾燥方式	ドライエア乾燥
駆動方式	AC サーボモータ
回転数	500 ~ 1500 min <sup>-1</sup>
<b>供給部・収納部</b>	
方式	カセットキャリア方式 (オプションあり)
<b>諸元</b>	
<b>装置の寸法・重量</b>	
W-GM-5200-3C	2515 (W) x 1475 (D) x 2000 (H) / *2300mm 5000 kg * 表示灯高さ
W-GM-5200-8C	3040 (W) x 1775 (D) x 2000 (H) / *2300mm 5000 kg * 表示灯高さ

## 株式会社東京精密

(本社) 〒192-8515 東京都八王子市石川町 2968-2  
TEL: (042) 642-1701 FAX: (042) 642-1798  
<https://www.accretch.jp/>

お問い合わせ先



●仕様などの記載事項は製品改良のためお断りなしに変更することがあります。